



### 产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

|   |   |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量  | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力  | 不适合采用焊接工艺   |

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



### 客户还购买了



### 文档

#### 产品图纸

5P.MODULAR CONN.MICRO RELAY W.

英文版本

#### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_284106-4\\_D.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_284106-4\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_284106-4\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

